



平成 23 年 8 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 M A R U W A
代 表 者 代表取締役社長 神 戸 誠
(コード番号：5344 東証・名証第1部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 丹 羽 邦 人
(TEL 0561-51-0841)

発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 23 年 8 月 15 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行(一般募集)

(1) 発行価格(募集価格)	1 株につき	3,108 円
(2) 発行価格の総額		3,418,800,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,979.80 円
(4) 払込金額の総額		3,277,780,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	1,638,890,000 円
	増加する資本準備金の額	1,638,890,000 円
(6) 申込期間	平成 23 年 8 月 24 日(水) ～ 平成 23 年 8 月 25 日(木)	
(7) 払込期日	平成 23 年 8 月 30 日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 公募による自己株式の処分(一般募集)

(1) 処分価格(募集価格)	1 株につき	3,108 円
(2) 処分価格の総額		777,000,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	2,979.80 円
(4) 払込金額の総額		744,950,000 円
(5) 申込期間	平成 23 年 8 月 24 日(水) ～ 平成 23 年 8 月 25 日(木)	
(6) 払込期日	平成 23 年 8 月 30 日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売 出 株 式 数		200,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	3,108 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		621,600,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 23 年 8 月 24 日(水) ～ 平成 23 年 8 月 25 日(木)	
(5) 受 渡 期 日		平成 23 年 8 月 31 日(水)

4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	2,979.80 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		(上限)595,960,000 円
(3) 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 の 額	増 加 する 資 本 金 の 額	(上限)297,980,000 円
	増 加 する 資 本 準 備 金 の 額	(上限)297,980,000 円
(4) 申 込 期 間 (申 込 期 日)		平成 23 年 9 月 13 日(火)
(5) 払 込 期 日		平成 23 年 9 月 14 日(水)

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)、処分価格(募集価格)及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 23 年 8 月 23 日(火)	3,205 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 23 年 8 月 26 日(金)から平成 23 年 9 月 7 日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,568,690,000 円については、全額を、当社並びに当社子会社 Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd. のセラミック部品事業における設備投資資金に充当する予定であります。Maruwa (Malaysia) Sdn. Bhd. の設備投資においては、当社から必要資金を投融資する予定です。

今回の設備投資は、平成 23 年 9 月から平成 25 年 3 月までの間に、(1) 温暖化対策・省エネルギー対策で注目されているハイブリッド自動車・電気自動車、風力発電、高速鉄道等のインバーターに使用されるパワーモジュール用セラミック基板に 2,823 百万円を、(2) おサイフケータイに代表される携帯電話の非接触通信機能を正確に作動させるための高機能携帯電話向け EMC 対策部品に 1,110 百万円を、及び(3) 道路灯・街路灯等の高輝度照明機器に使用されるパワー LED 向けの LED セラミックモジュール基板に残額を充当し、増産体制の構築を図るものであります。

当社グループは、これらの物作りにおいて、既存材料の性能改善と新規材料の開発で、高度化する市場ニーズに対応してまいります。

なお、当社グループの設備投資計画の内容については、平成 23 年 8 月 15 日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。